

**Toshiba annonce de nouveaux circuits bridge pour relier caméras/appareils photos et écrans dans les terminaux mobiles**

*Ces circuits bridge offrent une performance de transmission de données jusqu'à 800 Mbit/s pour les caméras et afficheurs haute résolution*

**Mobile World Congress, le 15 février 2010** – [Toshiba Electronics Europe](#) annonce ce jour la disponibilité de trois nouveaux circuits bridge pour les téléphones mobiles, un circuit d'interface série MIPI® (Mobile Industry Processor Interface) pour caméra/appareil photo (CSI) vers une interface MDDI® (Mobile Display Digital Interface), portant la référence TC358740XBG, et deux circuits d'interface série pour l'affichage (DSI) MDDI-MIPI, référencés TC358760XBG et TC358761XBG. Ces produits constituent des interfaces séries haute vitesse entre le processeur d'application ou bande de base d'un téléphone mobile et l'écran ou la caméra présente dans ce téléphone. Ce type d'interface est désormais nécessaire pour les caméras et les écrans de haute résolution présents dans les smartphones, les terminaux mobiles Internet, les netbooks, les smartbooks et dans d'autres dispositifs mobiles de hautes performances. Ce sont les circuits derniers-nés de la gamme des circuits Embedded Mobile Peripheral SoC de Toshiba.

Les smartphones et autres terminaux mobiles gagnent désormais en intelligence, en supportant des fonctions comme la vidéo haute définition, les graphiques 3D, la saisie d'images fixes et de signaux vidéo en haute résolution, et même la visioconférence. Grâce à leurs interfaces haute vitesse MIPI et MDDI, les nouveaux circuits bridge de Toshiba permettront aux utilisateurs de concevoir des terminaux mobiles capables de traiter aisément les fonctions de communication en bande passante élevée entre l'écran, la caméra et le processeur d'application ou de bande de base, apportant ainsi une expérience vidéo sans compromis.

Le circuit bridge pour caméra, référencé TC358740XBG, offre la connectivité entre les caméras MIPI et les processeurs d'application ou bande de base en utilisant une interface MDDI. Le circuit bridge supporte le standard MDDI 1.2 Type 2 côté hôte. Le composant peut traiter jusqu'à deux caméras, la caméra primaire utilisant une liaison MIPI et la caméra secondaire utilisant une liaison MIPI ou un port parallèle. Le bridge autorise l'interfaçage série haute vitesse aussi bien du côté hôte via MDDI que du côté caméra via MIPI CSI-2. La caméra primaire peut avoir une résolution jusqu'à 12 millions de pixels et la caméra secondaire jusqu'à 2 millions de pixels, le tout dans un même téléphone portable. Le composant est compatible avec des systèmes utilisant des processeurs bande de base de Qualcomm® avec une interface MDDI.

Les circuits bridge pour écrans, référencés TC358760XBG et TC358761XBG, sont optimisés pour les téléphones mobiles utilisant une interface hôte MDDI numérique série haute vitesse et offre une connectivité entre les écrans MIPI et les processeurs de bande de base et d'applications avec une interface MDDI. Ils sont adaptés aux interfaces MDDI 1.2 Type 1 et MIPI DSI 1.01, mais restent compatibles MDDI 1.1. Ils supportent le rafraîchissement direct via la liaison MDDI. Le circuit TC358761XBG supporte en outre les interfaces parallèles existantes telles que MIPI DPI et MIPI DBI côté hôte ou côté afficheur, ce qui permet de réutiliser ou d'utiliser plus longtemps des conceptions et des composants existants. Ces circuits sont compatibles avec des systèmes utilisant des processeurs de bande de base de Qualcomm® avec une interface MDDI.

**Disponibilité**

Des échantillons d'ingénierie des circuits bridge TC358761XBG (afficheur) et TC358740XBG (caméra) sont aujourd'hui disponibles. Des échantillons d'ingénierie du bridge affichage TC358760XBG seront disponibles en avril 2010. La production de volume du circuit TC358740XBG devrait démarrer au 3e trimestre 2010. Le démarrage de la production de volume

---

des circuits TC358760XBG et TC358761XBG est prévu au 4e trimestre 2010.

###

MIPI est une marque utilisée sous licence de la MIPI Alliance, Inc. aux Etats-Unis et sous d'autres juridictions. Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated. MDDI est une marque déposée de la VESA (Video Electronics Standards Association).

### A propos de Toshiba

Toshiba Electronics Europe (TEE) est la filiale européenne dédiée aux composants électroniques de Toshiba Corporation qui figure parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de semiconducteurs. TEE offre l'une des plus vastes gammes de circuits intégrés et de produits discrets de l'industrie, incluant des mémoires, des microcontrôleurs, des ASIC, des ASSP et des afficheurs de haut de gamme pour des applications dans l'automobile, le multimédia, l'industriel, les télécoms et les réseaux. L'entreprise commercialise aussi une vaste gamme de semiconducteurs de puissance. TEE avait été créée en 1973 à Neuss, en Allemagne, avec comprend des activités de conception, de production, de marketing et de ventes ; elle a désormais son siège à Düsseldorf, Allemagne, avec des filiales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. TEE emploie environ 300 personnes en Europe ; son président est M. Hitoshi Otsuka.

Toshiba Corporation est un groupe leader mondial et novateur dans le domaine de la haute technologie, un fabricant et un fournisseur diversifié de produits électroniques et électriques pour un vaste nombre d'applications : des systèmes informatiques et de communications ; des produits pour l'électronique grand public ; des composants et des dispositifs électroniques ; des systèmes de puissance, y compris dans l'énergie nucléaire ; des systèmes pour les infrastructures industrielles et sociales ; et des appareils électroménagers. Créé en 1875, Toshiba possède aujourd'hui un réseau global de plus de 740 sociétés, qui emploie 199000 personnes dans le monde et réalise plus de 73 milliards de \$ de ventes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : [www.toshiba-components.com](http://www.toshiba-components.com)

### Personne à contacter pour les questions concernant la publication

Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: <http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp>

E-mail: ASIC/SOC: [customsoc-internet@toshiba-components.com](mailto:customsoc-internet@toshiba-components.com)

### Pour des informations concernant la publication, contactez:

Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe

Tel: +49 (211) 5296 117

E-mail: [HRausch@tee.toshiba.de](mailto:HRausch@tee.toshiba.de)

### Publié par:

Simon Flatt/Andrew Town, Pinnacle Marketing Communications Ltd.

Prosperity House, Dawlish Drive, Pinner, HA5 5LN, UK

Tel: +44 (0) 20 8869 9229/+44 (0) 20 8429 6546 Fax: +44 (0) 20 8868 4373

E-mail: [simon@pinnaclemarcom.com](mailto:simon@pinnaclemarcom.com) ou [andrew@pinnaclemarcom.com](mailto:andrew@pinnaclemarcom.com)

Web: [www.pinnacle-marketing.com](http://www.pinnacle-marketing.com)

Février 2010

Réf. : 5997/A